

2025年3月期機関投資家様向け 会社説明会

2024年 9月 9日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。



当社グループの事業セグメント

エレクトロニクス事業 (エレキ事業)

プリント基板(PCB)用部材を始めとする電子部品用化学品部材の開発・製造販売及び仕入販売



医療・医薬品事業 (医薬事業)

医療用医薬品の製造販売・製造受託
歯科技工物の製造販売



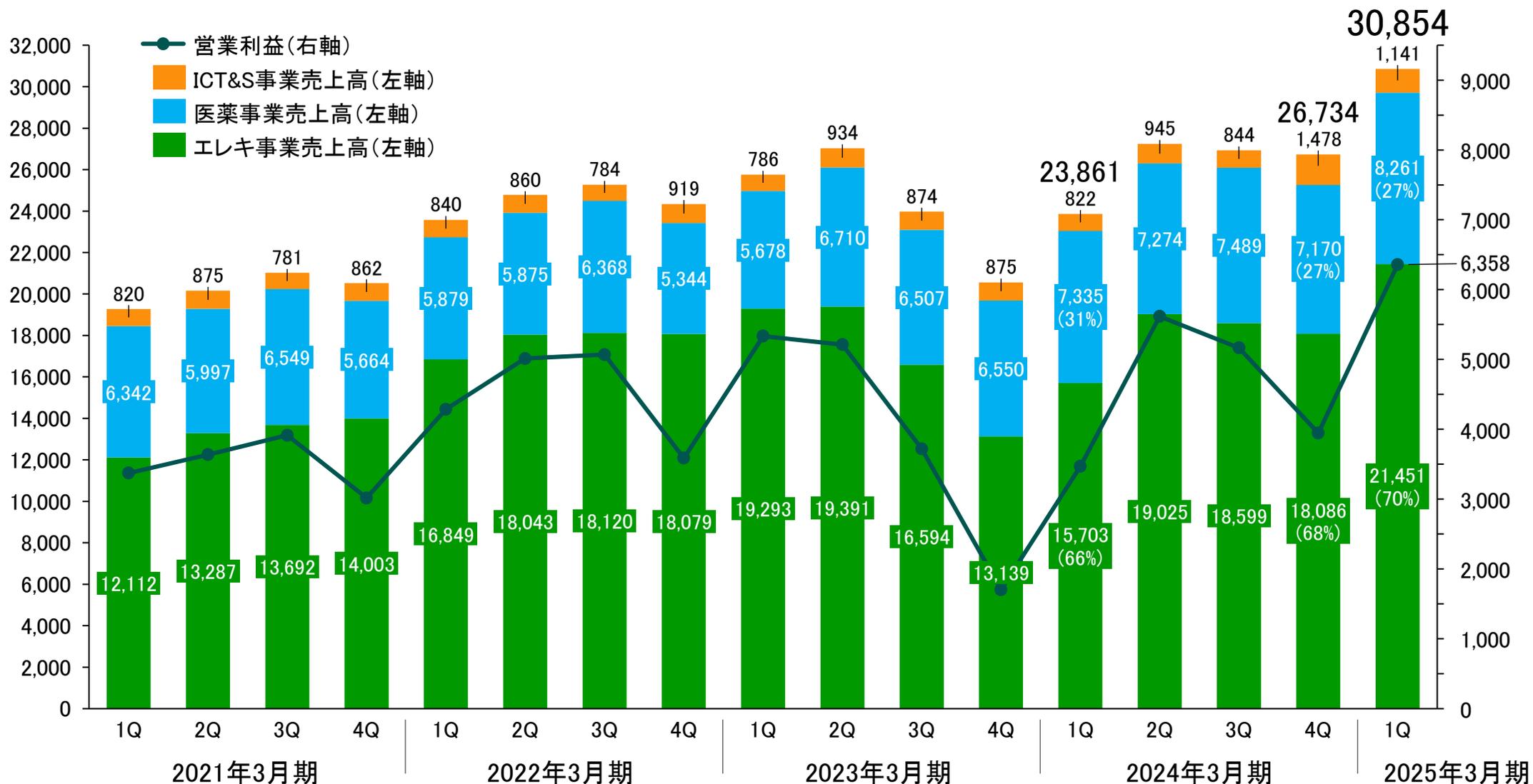
ICT&S事業

ICT事業、ファインケミカル事業、
エネルギー事業及び食糧事業等



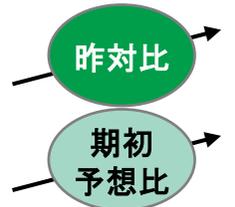
四半期別推移(売上高・営業利益)

単位:百万円



2025年3月期 通期業績予想修正

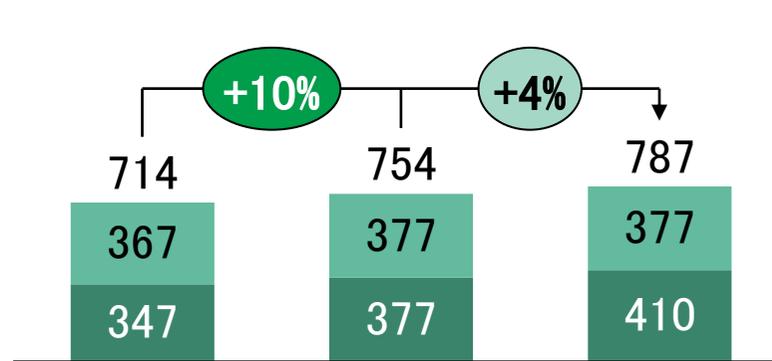
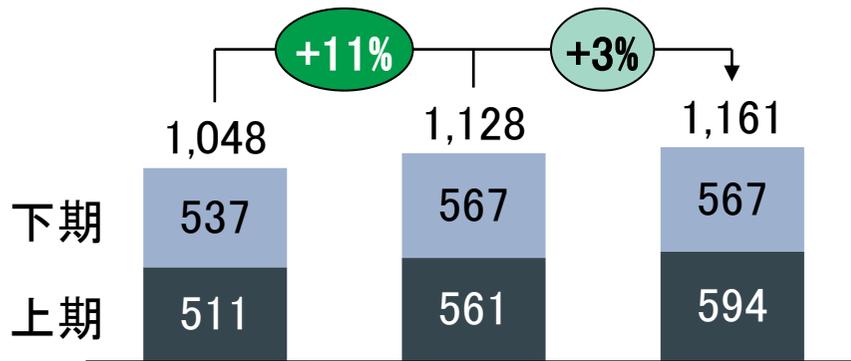
✓ 期初予想を修正。1Qのエレキの実績と予想の差分のみ修正。



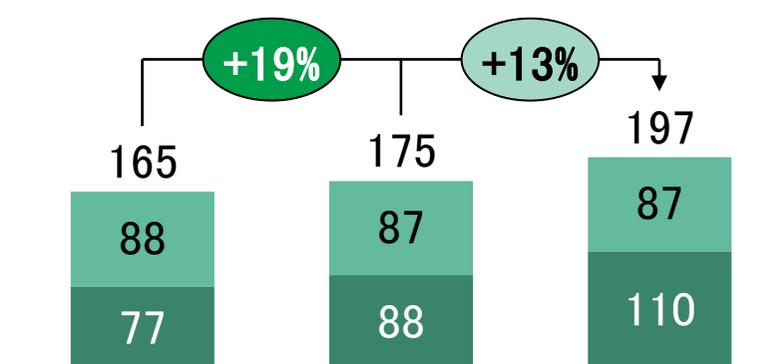
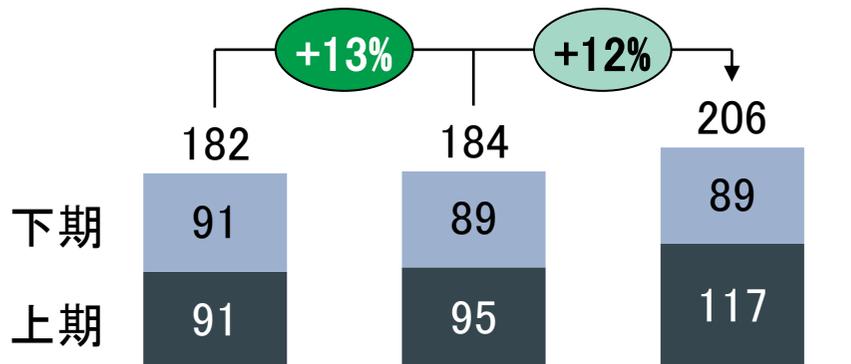
連結

エレキ

売上高(億円)



営業利益(億円)



業績予想比
為替効果

- 売上: 約15億円
- 営業利益: 約7億円

数量増

- 白色DF予想比大幅増
- PKG、リジッド高機能液状、リジッド汎用も予想比増

医薬修正なし

*1 2025年3月期通期業績予想 円・USDレート145.0円

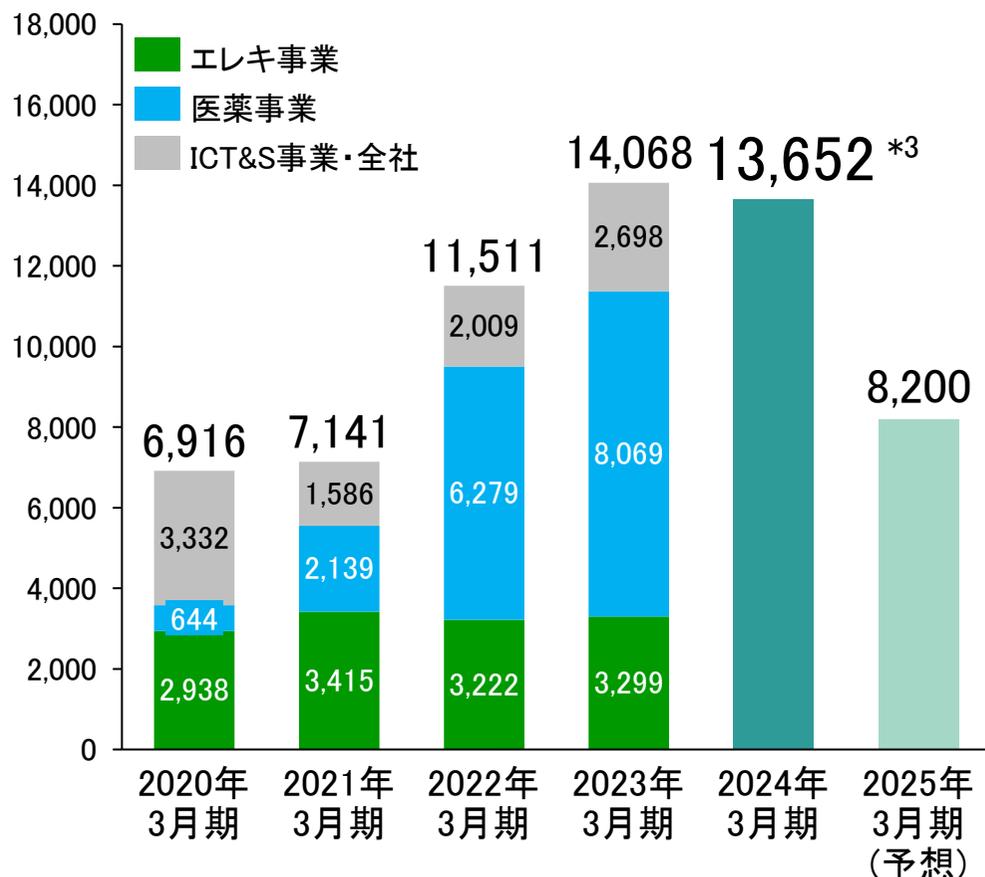
*2 2025年3月期第1四半期 実績 円・USDレート156.5円

2025年3月期第2四半期～第4四半期 期初業績予想据え置き 円・USDレート145.0円

設備投資額・減価償却費推移

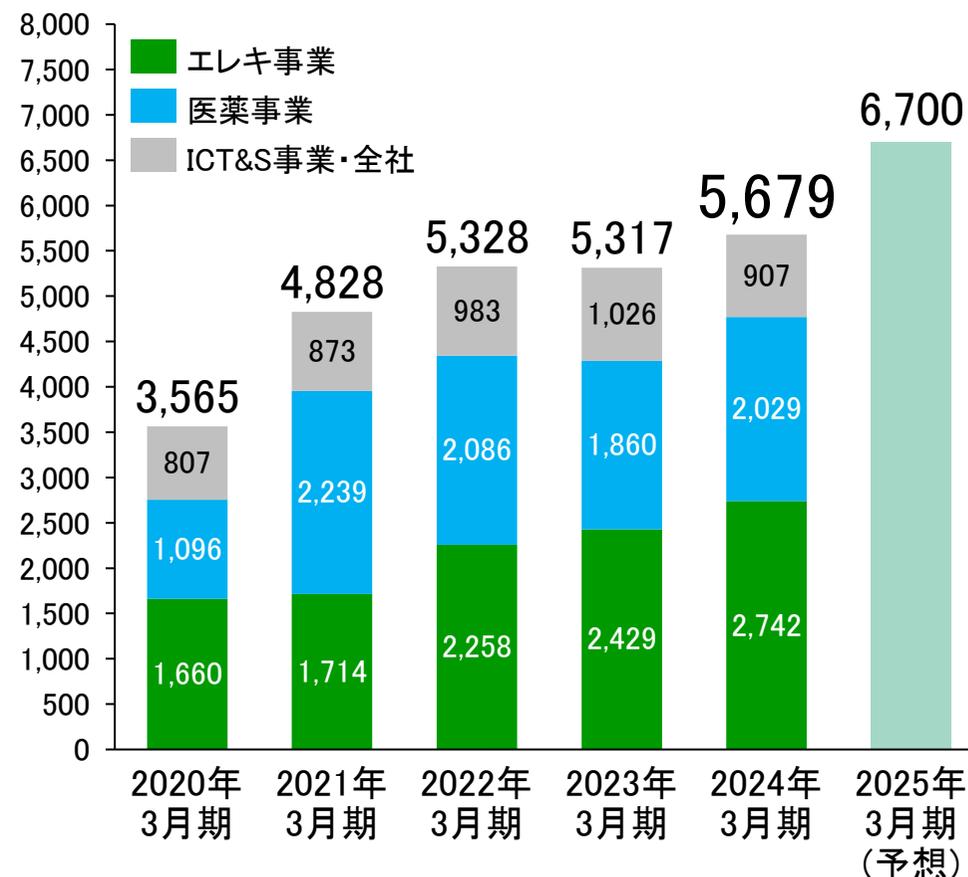
設備投資額 *1

単位: 百万円



減価償却費 *2

単位: 百万円



*1 設備投資額: 有形固定資産とソフトウェアに対する投資額

*2 減価償却費: 有形固定資産とソフトウェアに関する償却費

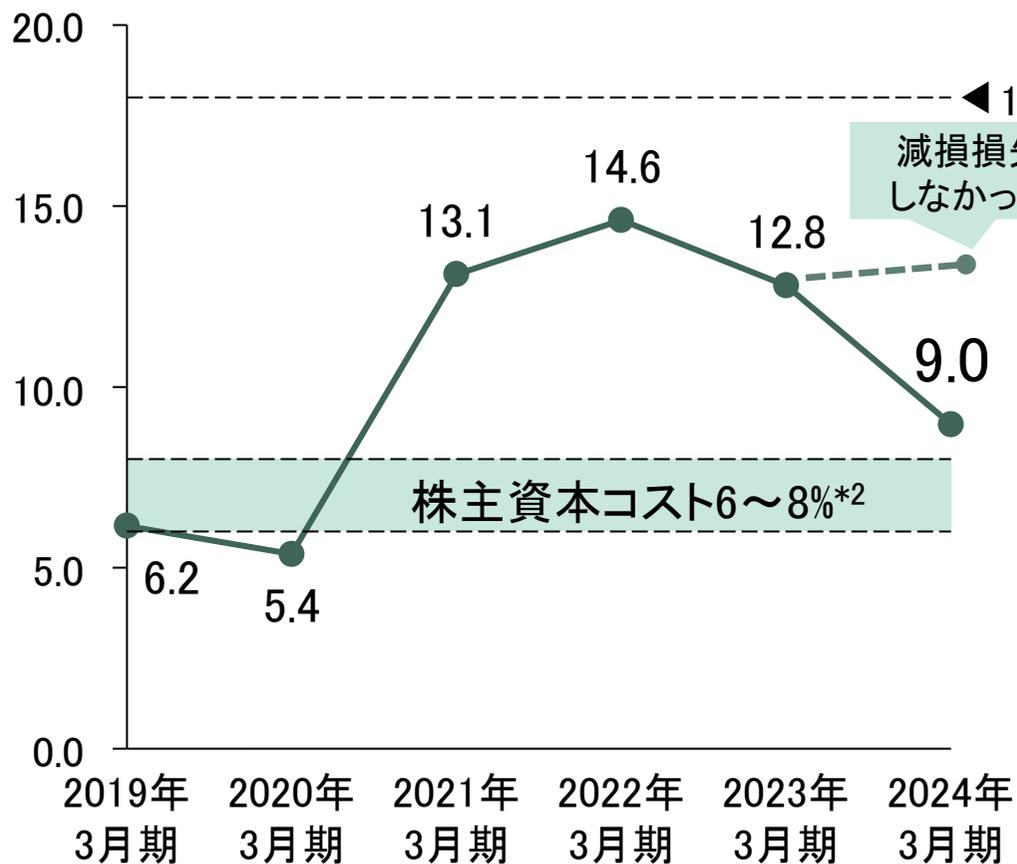
*3 内訳 エレキ事業: 12,190M、医薬事業: 1,882M、ICT&S事業: 556M

全社: △977M (全社の建設仮勘定をエレキ事業子会社へ譲渡したことにより負の値となっています。)

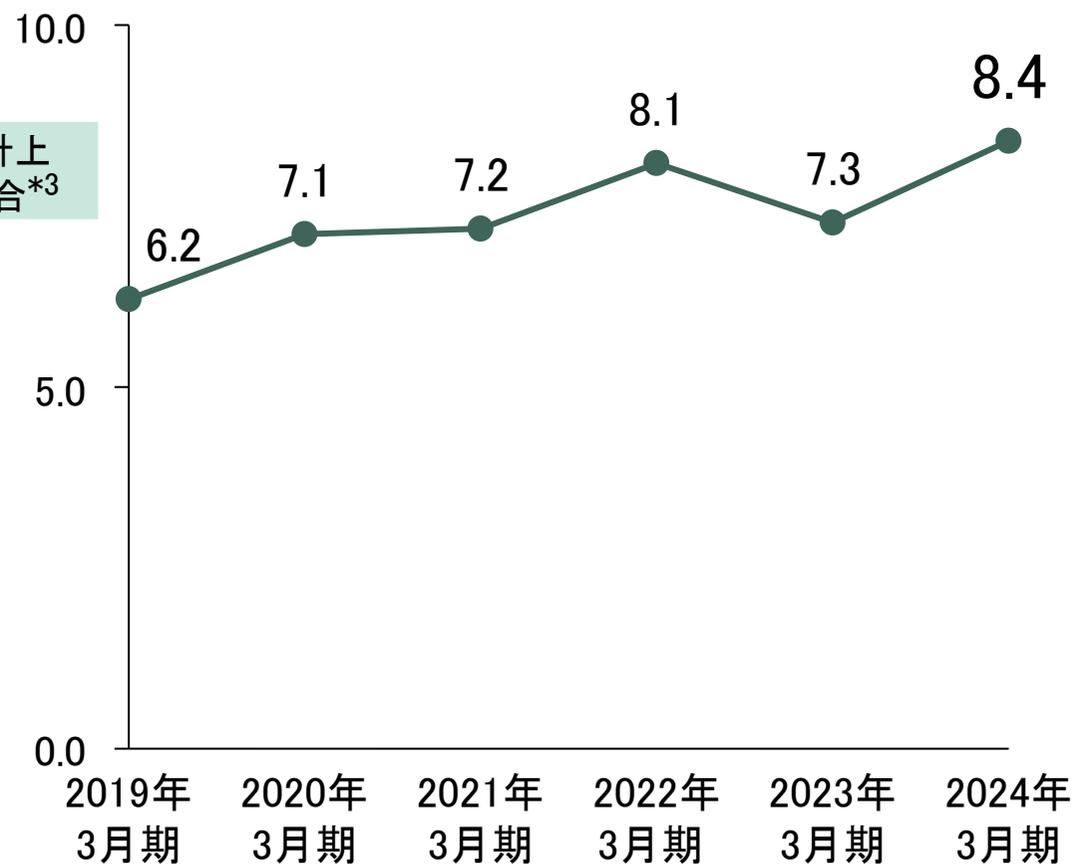
連結ROE・ROIC推移

- ✓ 長期経営構想における2030年目標値ROE18%達成に向けて改善していきます。

ROE(自己資本利益率)*1 単位:%



ROIC(投下資本利益率)*1 単位:%



*1 ROE: 親会社株主に帰属する当期純利益 / 自己資本の期中平均

ROIC: 税引後営業利益 / (有利子負債残高+純資産)の期中平均

*2 リスクフリーレート(国債利回り)0.7%+太陽HD β 値 1.1~1.2 \times リスクプレミアム 5~6%

*3 2024年3月期の当期純利益から減損損失の影響を除いた値を分子としてROEを計算

エレクトロニクス事業

エレクトロニクス事業沿革

1953 –
1984

創業の印刷用
インキから
SRへ事業転換

- 1953年 印刷用インキの製造販売を事業目的に「太陽インキ製造株式会社」を設立
- 1970年 PCB用部材の販売を開始
- 1976年 事業方針を転換しエレクトロニクス業界向けのSRを主力製品に
- 1984年 液状タイプ現像型SRの開発に成功、販売を開始

1988 –

エレキ事業の
海外展開

- 1988年 大韓民国に「韓国タイヨウインキ株式会社」を設立
- 1990年 アメリカ合衆国に「Taiyo America, Inc.」を設立
- 1996年 台湾に「台湾太陽油墨股份有限公司」を設立
- 2001年 埼玉県に北山事業所を開設
中華人民共和国に「太陽油墨(蘇州)有限公司」を設立

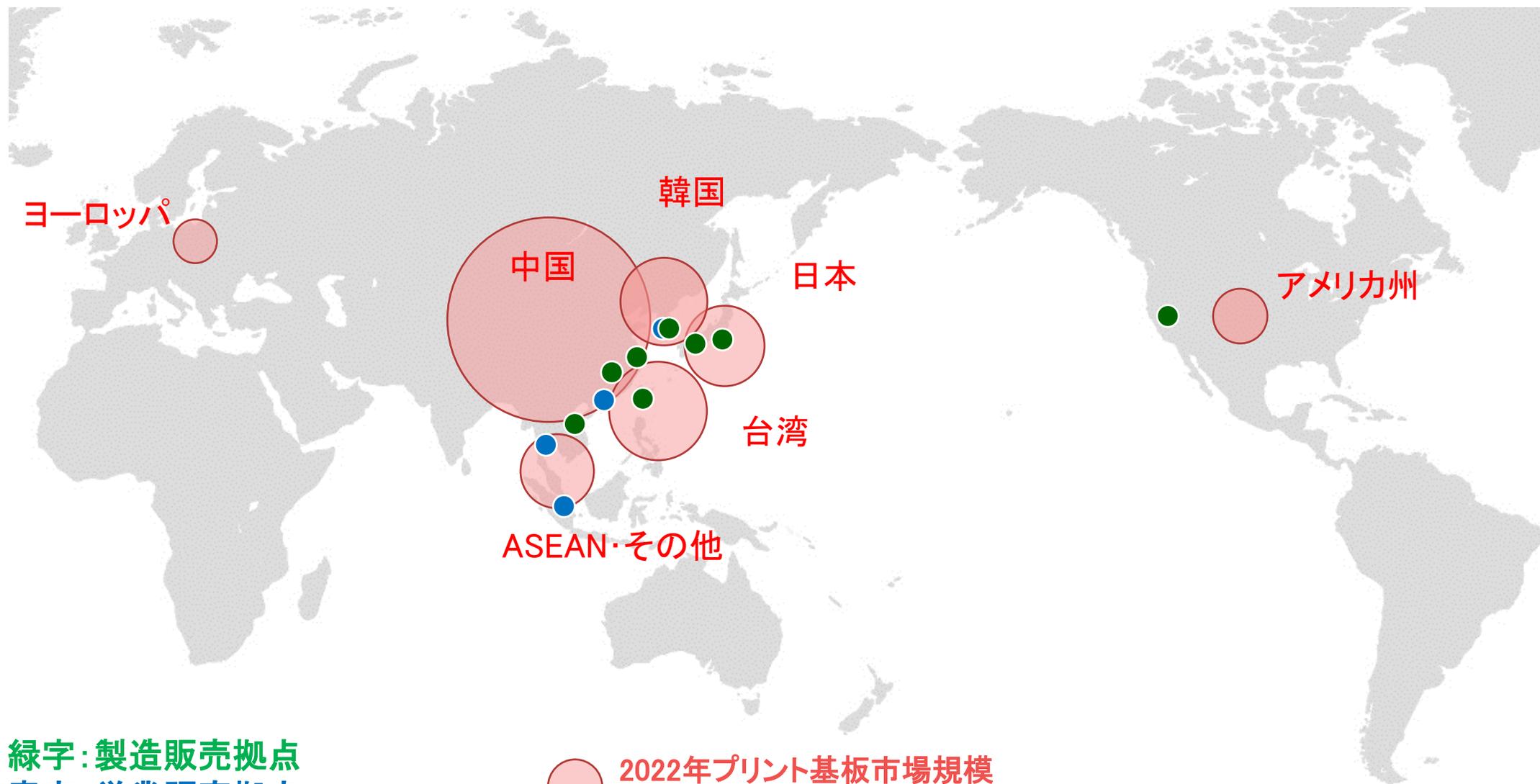
2006 –

高収益の
DFタイプSR
の販売開始

- 2006年 DFタイプSRの開発に成功、販売を開始
- 2013年 台湾の「永勝泰科技股份有限公司」を連結子会社化
- 2015年 「太陽インキ製造株式会社」第2生産拠点として福岡県に北九州事業所を開設
- 2020年 中華人民共和国に「永盛泰新材料(江西)有限公司」を設立
ベトナム社会主義共和国に「Taiyo Ink Vietnam Co., Ltd.」を設立
- 2024年 嵐山事業所内に技術開発センター「InnoValley」を開設

エレクトロニクス事業 関連拠点

- ✓ アジアを中心にグローバルに生産・営業拠点を有し、タイムリーな製品提供を実現。
- ✓ 複数の製造拠点を持つことで事業継続リスクを低減。



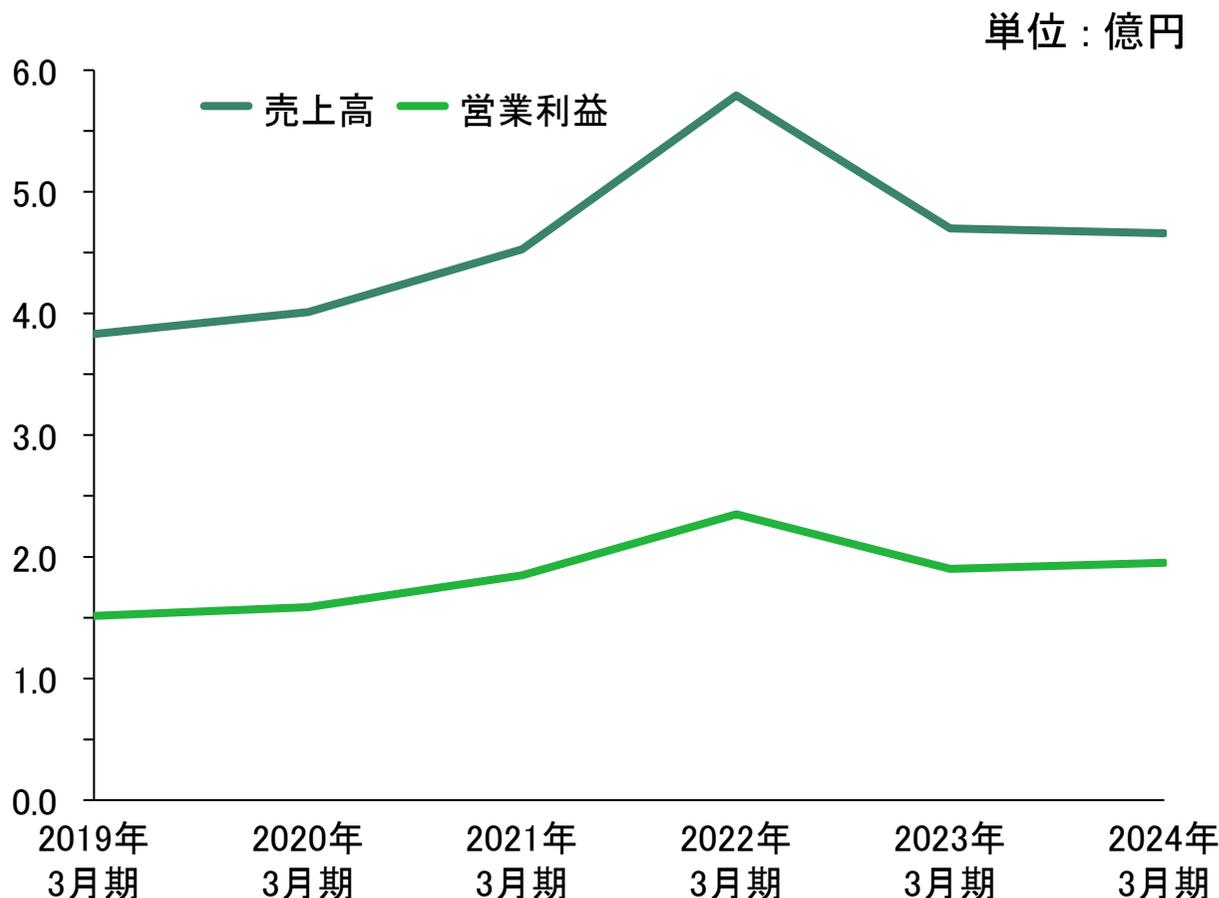
緑字: 製造販売拠点
青字: 営業販売拠点

2022年プリント基板市場規模
単位: USD、()内は市場全体に占める割合

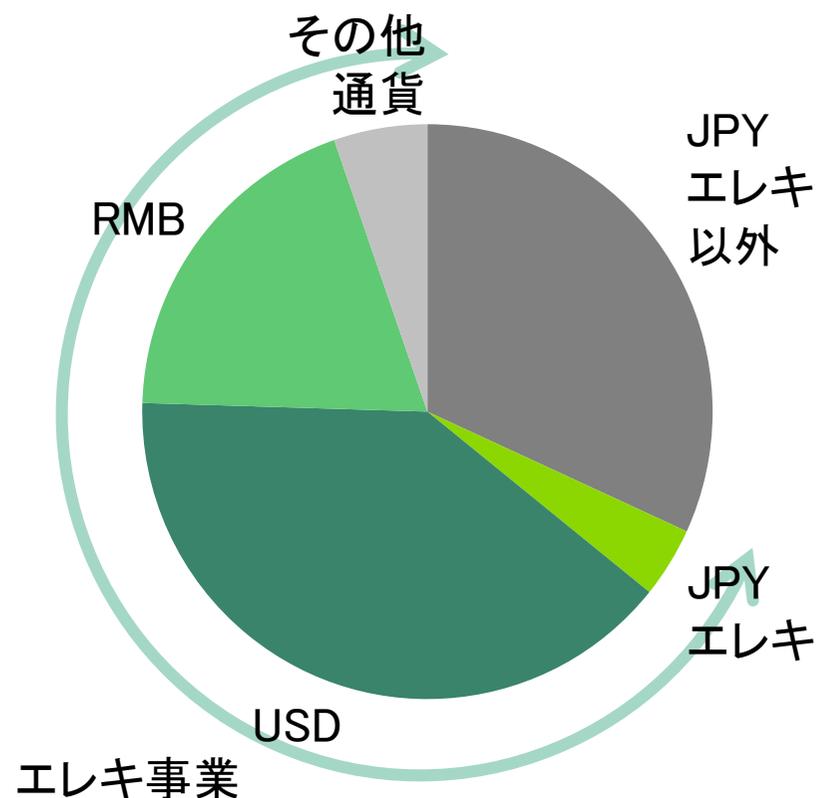
為替感応度推移と取引通貨比率

- ✓ 為替感応度は売上高、営業利益ともに19年3月期から増加傾向がみられます。
- ✓ 外貨取引はエレキ事業がほとんどであり、USD以外にRMBも多く取引しています。一方で医薬事業の影響は小さいです。

為替感応度推移



24年3月期取引通貨比率



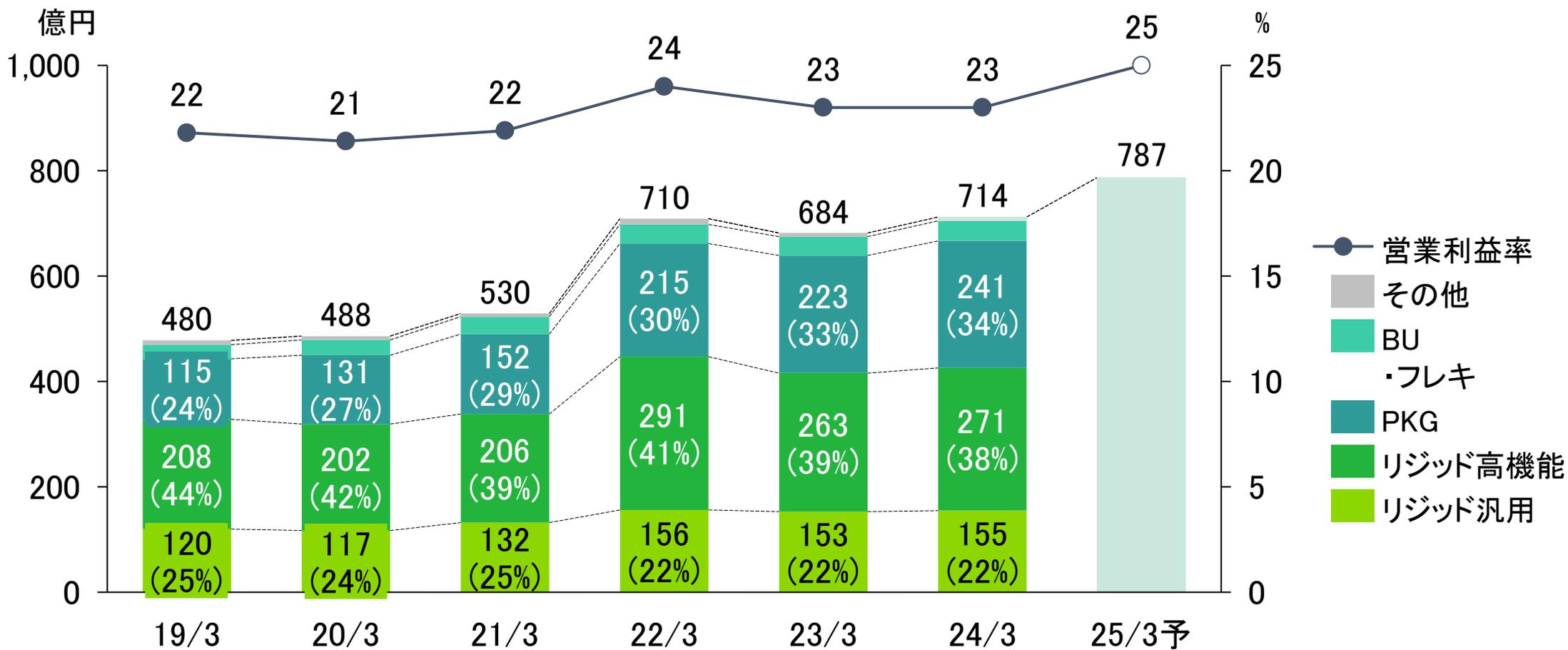
製品と市場

※ 単位:百万円

製品区分		概要	売上高※ 2024年3月期 (売上高比率)	主な アプリケーション	世界市場 シェア
リジッド	汎用	一般的なリジッド基板に 用いられるSR	15,584 (22%)	<ul style="list-style-type: none"> 白物家電 自動車 PC/タブレット スマホ 	中
	高機能	信頼性など高度な機能が 求められるリジッド基 板に用いられるSR	27,129 (38%)	<ul style="list-style-type: none"> PC/タブレット 自動車 スマホ サーバー/基地局 	高
半導体PKG		半導体パッケージ基板 に使用されるSR	24,106 (34%)	<ul style="list-style-type: none"> スマホ サーバー/基地局 PC/タブレット 	高
フレキ		フレキシブル基板SR 及び感光性カバーレイ フィルム	3,887 (5%)	<ul style="list-style-type: none"> スマホ PC/タブレット 	低
ビルドアップ		穴埋めインキ 層間絶縁材		<ul style="list-style-type: none"> スマホ PC/タブレット サーバー/基地局 	低

製品区分別 売上高推移

- ✓ 2024年3月期は、為替の円安推移、販売数量の増加により増収。
- ✓ 販売数量はリジッド高機能の車載、スマートフォン関連部材、PKGのメモリ向けが増加。



円・USD
レート

111	111	109	106	113	144	1Q実 157
						2-4Q予 145

新技術開発センター「InnoValley」竣工

- ✓ 太陽インキ製造は、2024年4月に技術開発センター「InnoValley」を竣工しました。開発部門の社員を中心に設計段階から関与し、従業員のポテンシャルを最大限に引き出す施設としてエレクトロニクス事業の成長をけん引します。



【所在地】 嵐山事業所敷地内(埼玉県)
【面積】敷地約1.6万m²、建床約1.0万m²
【階数】地上6階

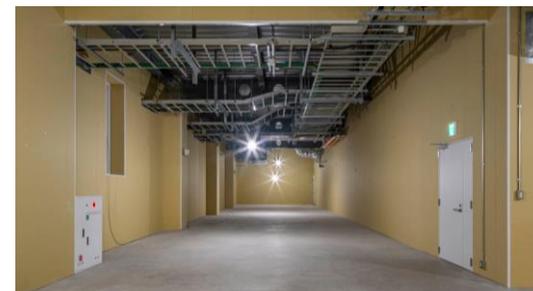
新技術開発センター「InnoValley」の特長

- ✓ 従業員のポテンシャルを最大限に引き出すグループ初の試みが随所に施されています。

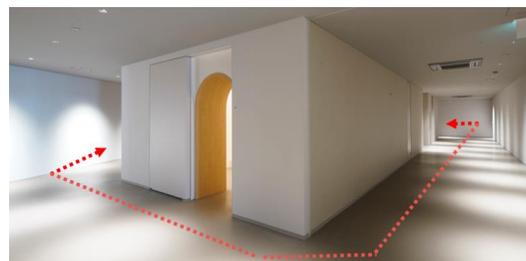
ABW型オフィス設置によるコミュニケーションの活性化



将来の事業展開を見据えた未実装エリアの設置

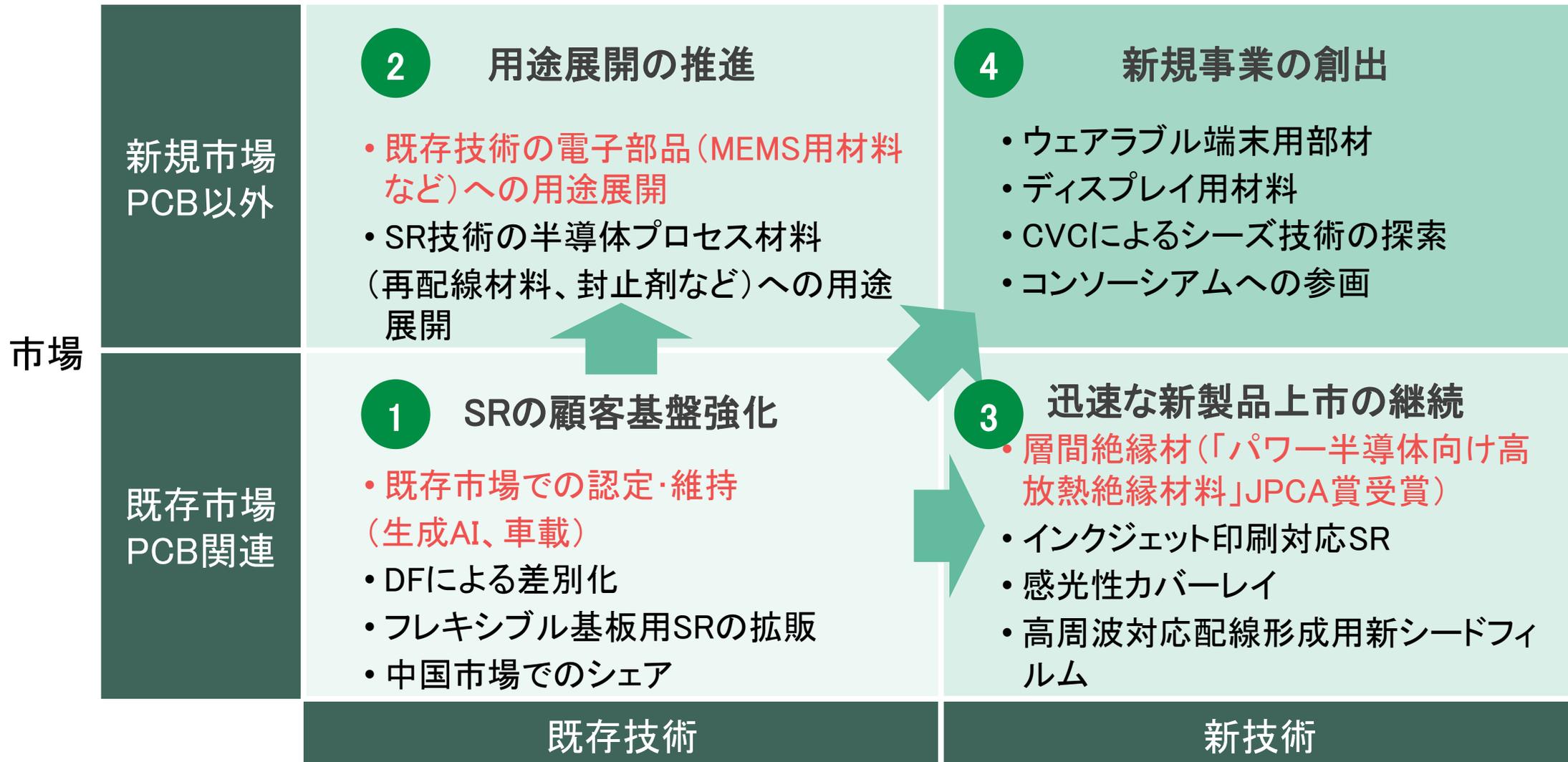


回遊式導線、試作装置の導入による開発スピードの向上



エレクトロニクス事業の成長戦略

✓SRの市場を拡大し、新製品・新規事業を立ち上げることで、事業の持続的な成長を目指します。



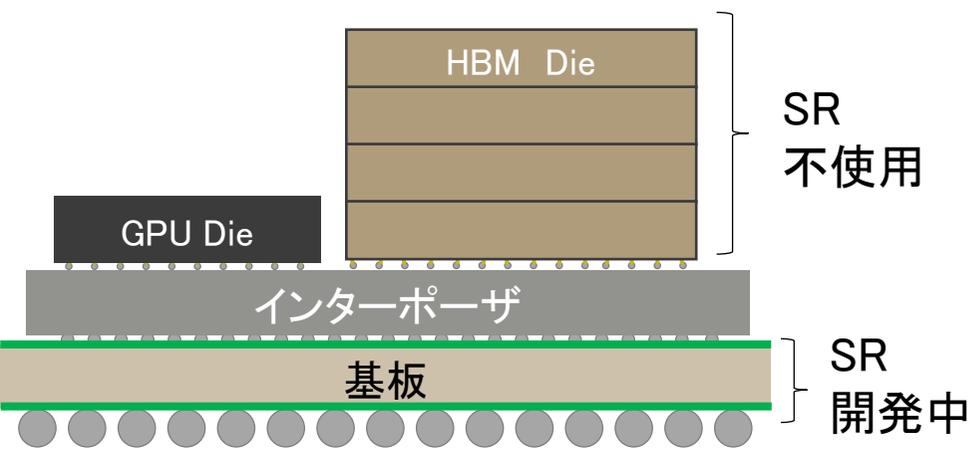
技術

1 既存市場 × 既存技術 成長市場: 生成AI

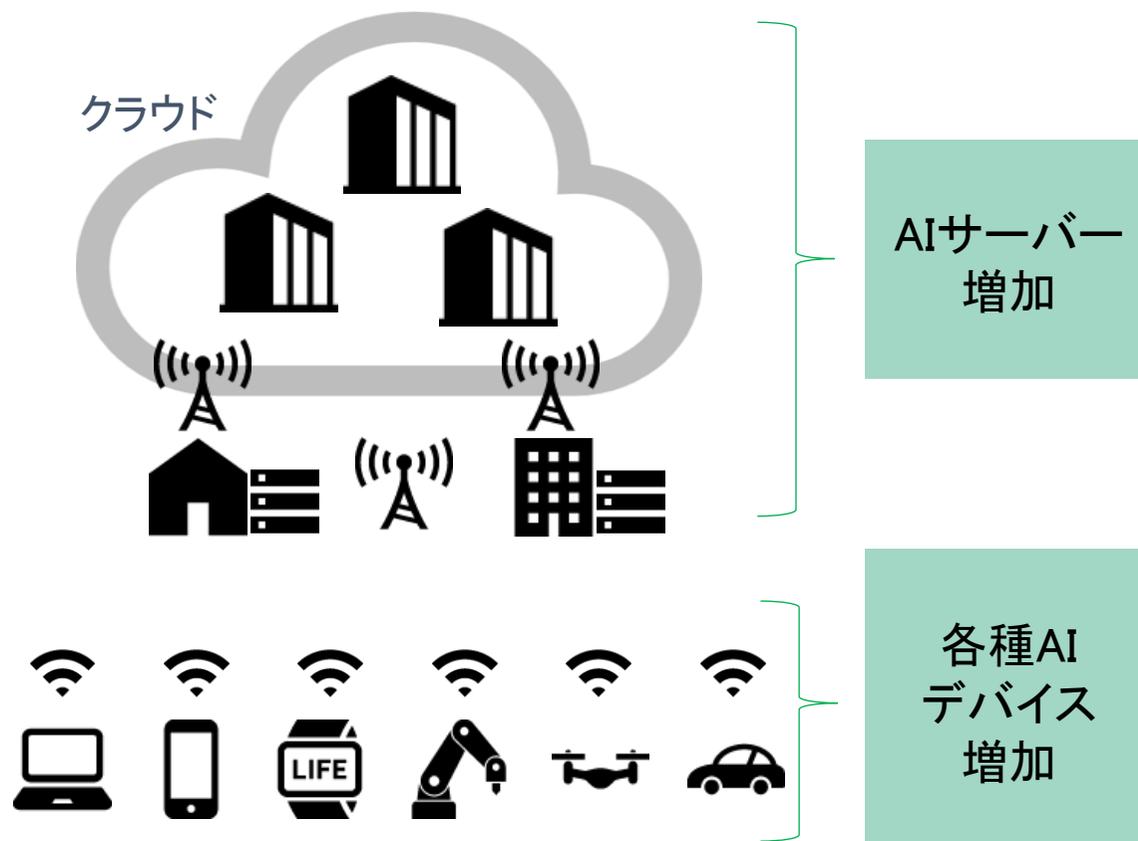
- ✓ 生成AI向けGPUへの採用は限定的なもの、情報処理量増加によるインフラ需要の増加や各種AIデバイスの増加は、中長期的に当社材料増加の好機となります。

生成AI向けGPU、HBM

- GPUのパッケージ基板には当社SRは採用されておらず、シェア獲得に向け開発品を顧客評価中。
- HBMはメモリパッケージを必要としない構造のためSRは使用せず。



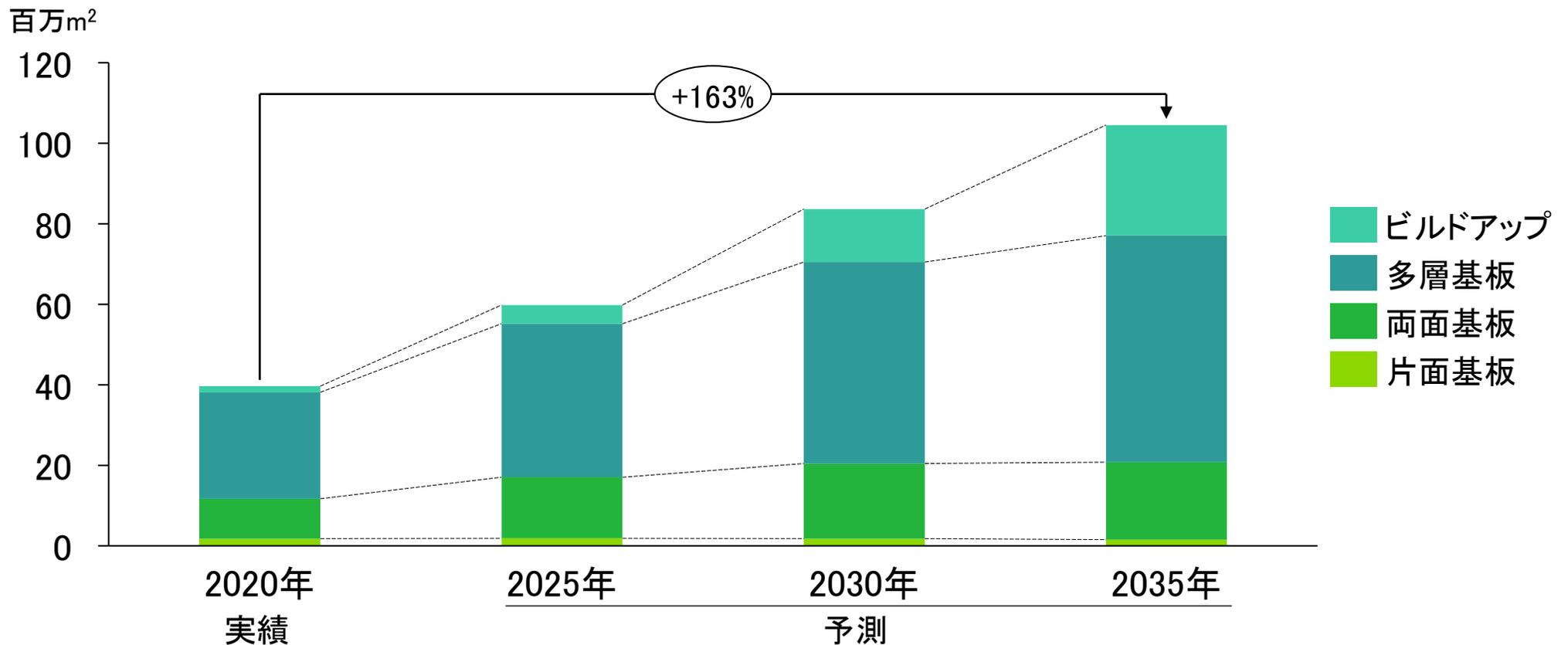
生成AI普及に寄る当社製品の採用機会



① 既存市場 × 既存技術 成長市場：車載用プリント配線板市場

- ✓ 自動車の電動化・電装化に伴い自動車1台当たりの基板面積は増加傾向にあり、これは、当社材料の数量増加につながる好機となります。

車載用プリント配線板市場規模推移*

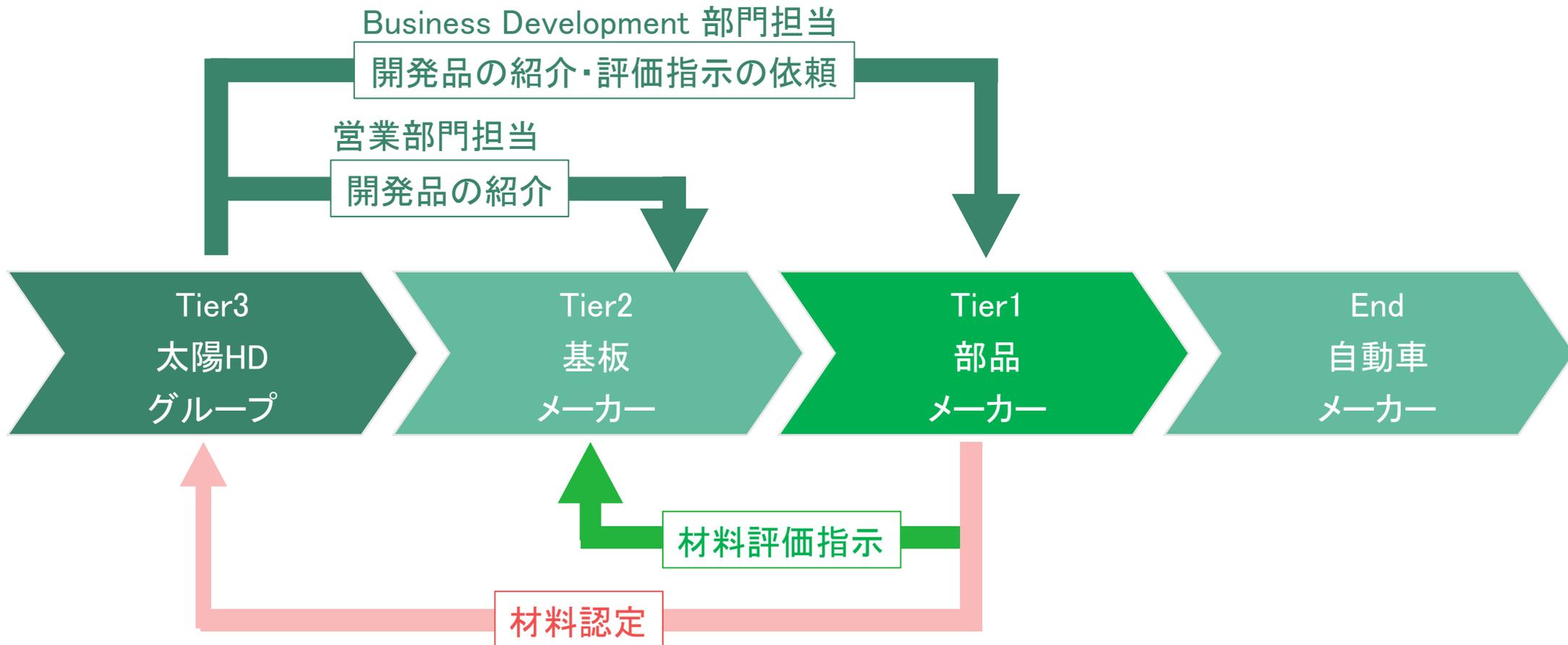


電動アプリケーション向けの多層基板等や、ADAS/自動運転向けビルドアップ基板の需要増加を背景に長期的に市場拡大見込み。

* 出典：富士キメラ総研「車載電装デバイス&コンポーネンツ総調査2022」

1 既存市場 × 既存技術 車載用SRのサプライチェーン

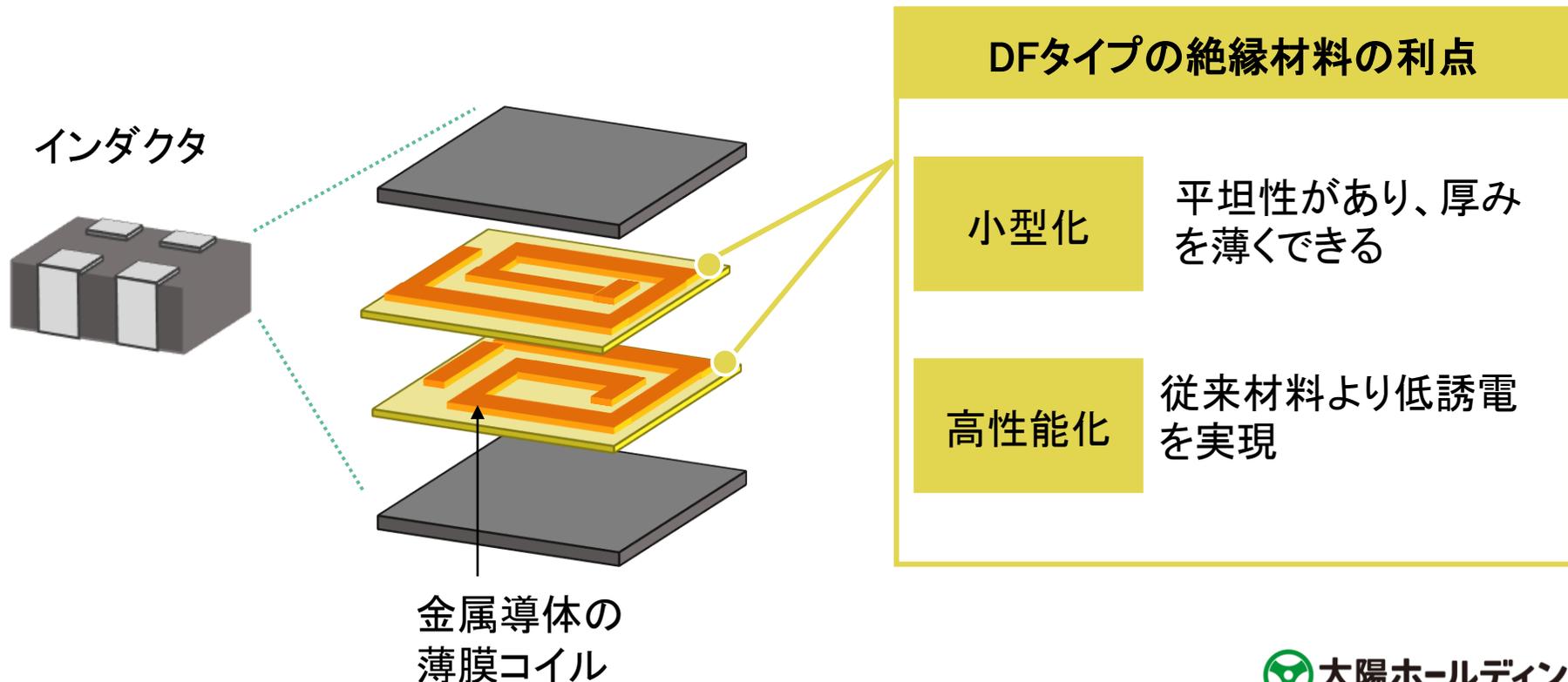
- ✓ 車載用材料は、信頼性試験等の厳しい要求特性を満たし材料認定を得る必要があります。参入障壁が高い分、一度採用されると切替えされにくい材料です。
- ✓ Tier2の基板メーカーに加え、材料認定・評価指示をするTier1とも連携し、今後も認定獲得・維持を目指します。



2 新市場 × 既存技術 既存技術の電子部品用途展開

- ✓ 電子部品の小型化・高性能化には、セラミック等従来の材料では達成困難な特性が求められます。
- ✓ 従来材料のアプローチとは異なる、当社の既存技術を応用して開発された材料が種々の電子部品に採用されています。

当社製品の採用例: インダクタ向けのDFタイプの絶縁材料



3 迅速な新製品上市の継続

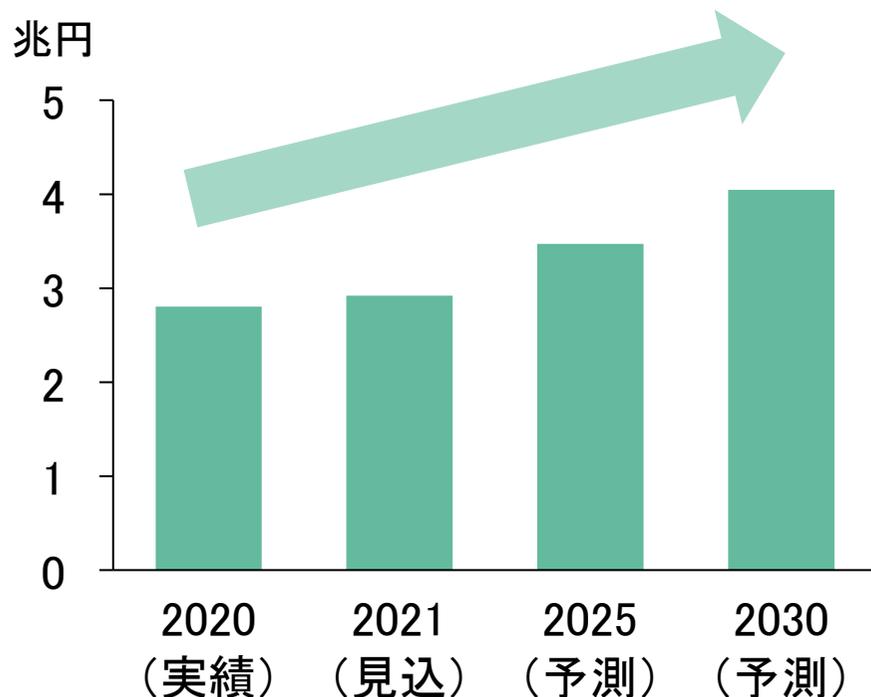
「パワー半導体向け高放熱絶縁材料」第20回 JPCA賞(アワード)を受賞



- ✓ 太陽インキ製造は高い放熱性を実現する「パワー半導体向け高放熱絶縁材料」で第20回 JPCA賞(アワード)を受賞しました。5年連続の受賞です。

パワー半導体の市場予測

- パワー半導体は、電力を制御・変換するデバイスで、自動車の電動化や再生可能エネルギーの変換等に必要。



パワー半導体搭載基板向け材料の課題

- 作動中に多くの熱を発生するパワー半導体を搭載した電子機器に対し、小型化・高性能化の要求も加わり、効率的な熱対策が課題。

パワー半導体を搭載する基板に
使用する材料にも高い放熱性が必要

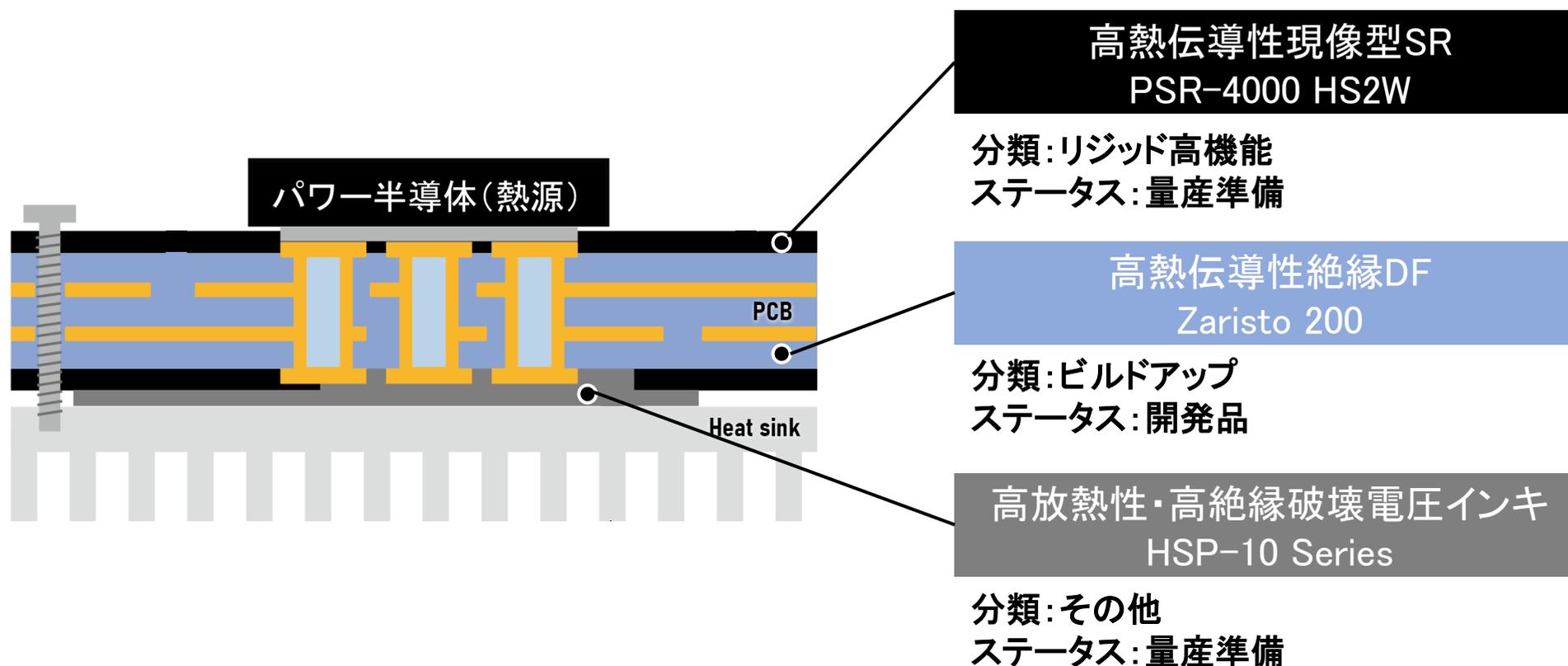
3 迅速な新製品上市の継続

「パワー半導体向け高放熱絶縁材料」第20回 JPCA賞(アワード)を受賞



- ✓ 配合・分散技術を活かし、高い放熱性を有する絶縁材料を3種開発し、パワー半導体搭載基板向けの材料として期待され受賞しました。

受賞製品



医療・医薬品事業

医療・医薬品事業への参入背景

- ✓ 事業環境、得意分野等を考慮し、化学をキーワードに高成長・高利益率が見込める業界を検討した結果、医薬品事業へ参入。

事業
環境

- エレクトロニクス事業は半導体市場やプリント基板市場と強い連動
- 主力製品のソルダーレジストのみに頼らない事業ポートフォリオの模索

X

得意
分野

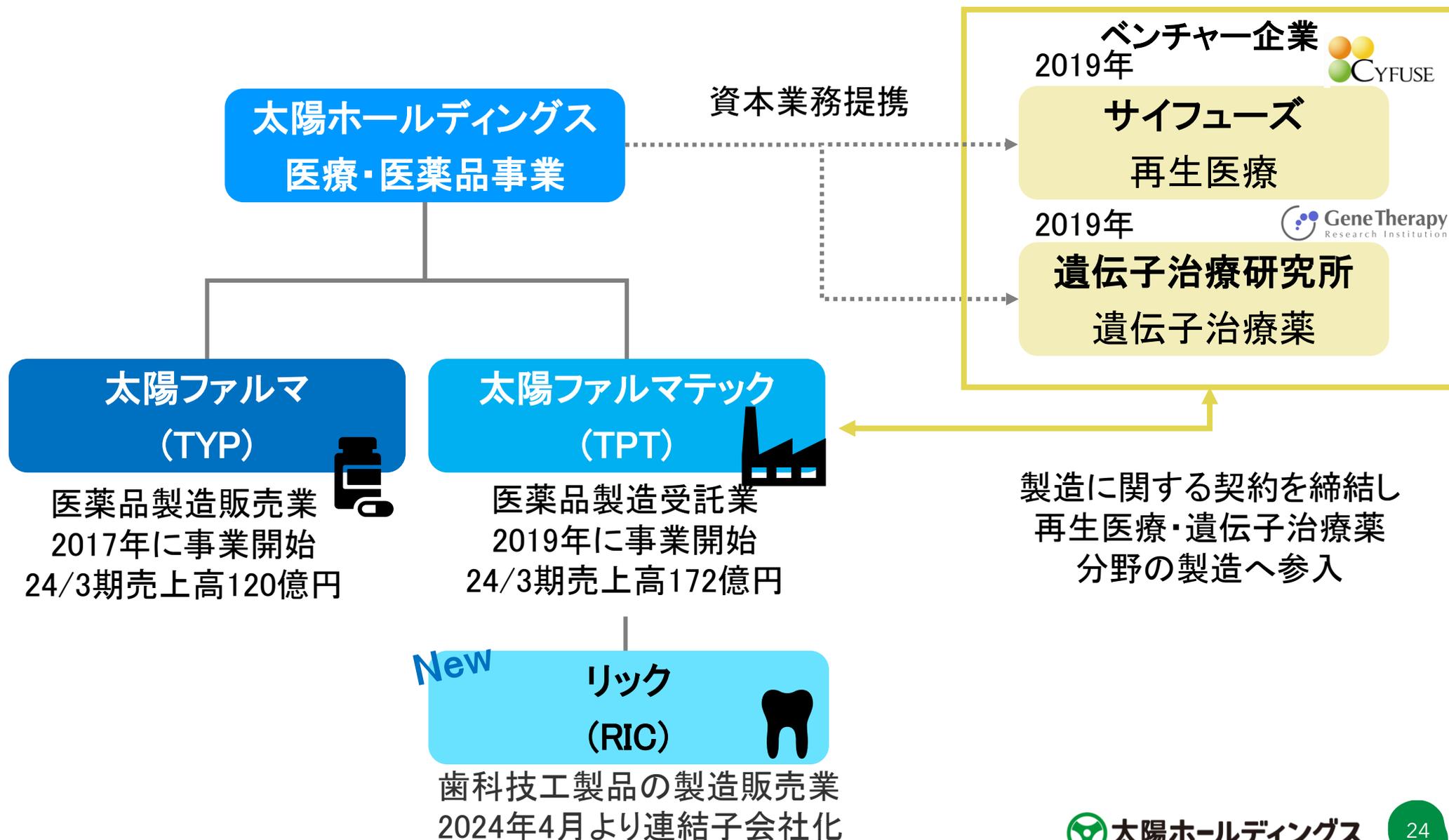
- エレクトロニクス事業で培った「化学」の知見
- 高品質な生産体制をグローバルに展開

高成長・
高利益率
が
見込める
業界

医療・医薬品
事業への参入

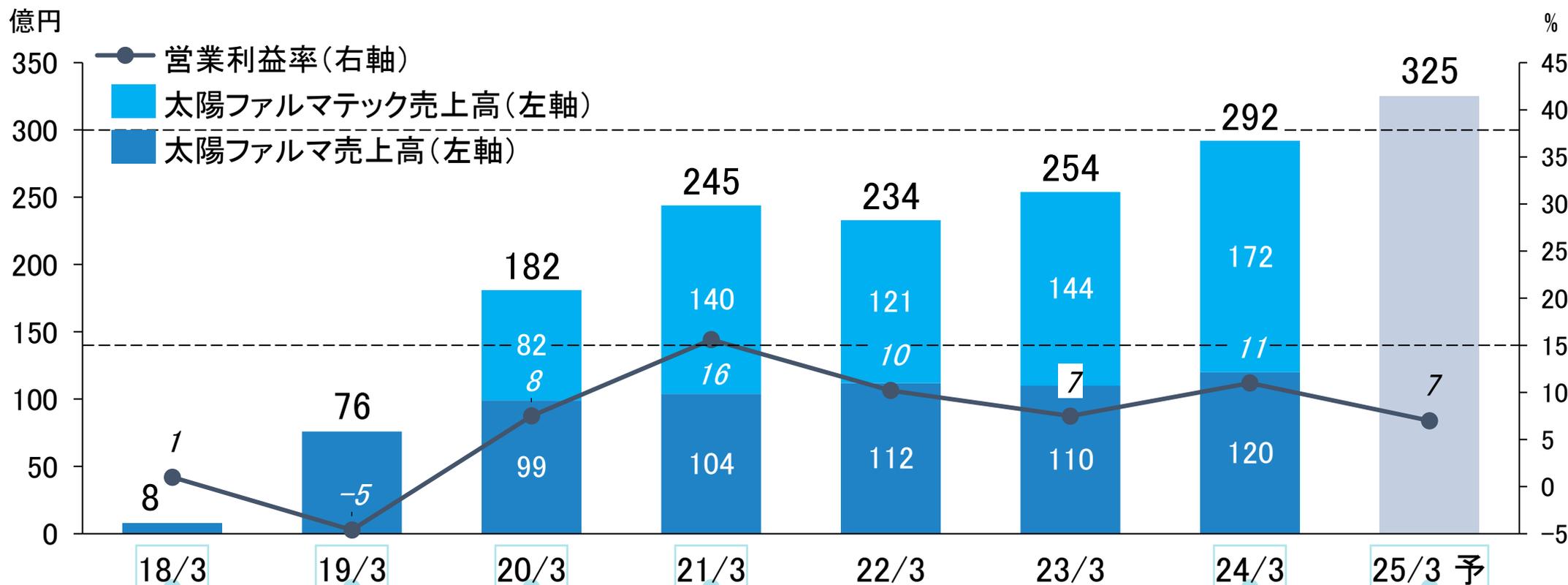
医療・医薬品事業の全体像

✓ 2017年よりエレクトロニクス事業に次ぐ第2の柱として、医療・医薬品事業に参入。



医療・医薬品事業 売上高・営業利益率推移

✓ 2018年に医療・医薬品事業に参入し、M&Aを通じ拡大させてきました。



• 太陽ファルマ設立
• 中外製薬より長期収載品13製品承継

• 日本ベーリンガーインゲルハイムより1製品承継

• 第一三共より高槻工場を承継し太陽ファルマテック設立

• アストラゼネカより4製品承継

• ヤンセンファーマより1製承継

• リックが連結子会社化

長期収載品とは?

新薬として発売された後に特許期間もしくは再審査期間が終了し、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の販売が可能となっている先発品

太陽ファルマ(製販) 長期収載品の選定療養制度による影響

- ✓ 2024年10月より導入される選定療養制度は太陽ファルマの業績にマイナス影響が出る見込みですが、対象となる製品は売上の20%程度であり後発品との価格差を考えると、今年度の影響は限定的と考えます。

選定療養の概要

●制度の概要

長期収載品と後発品の薬価差のうち1/4を
保険給付とせず患者負担に上乗せする制度

●対象品目

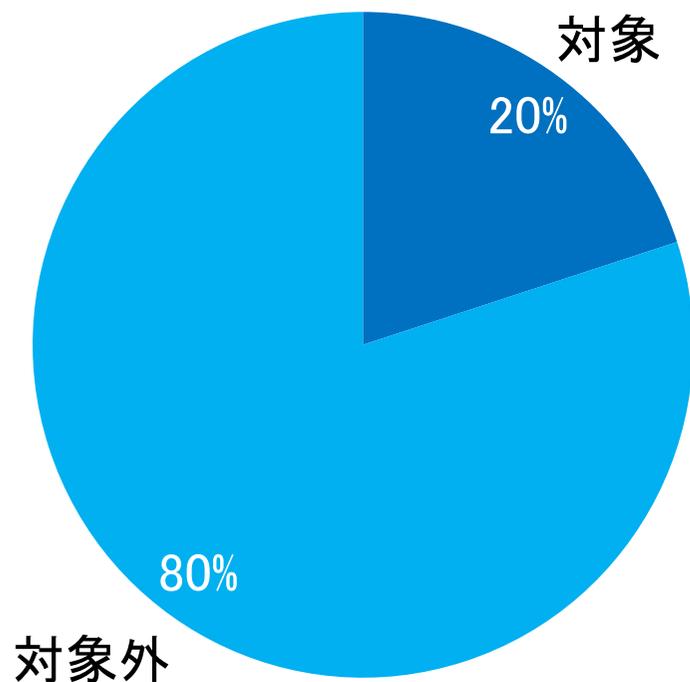
A)B)いずれかを満たす長期収載品

A) 後発医薬品の上市後、5年以上経過

B) 後発品への置き換え率が50%以上

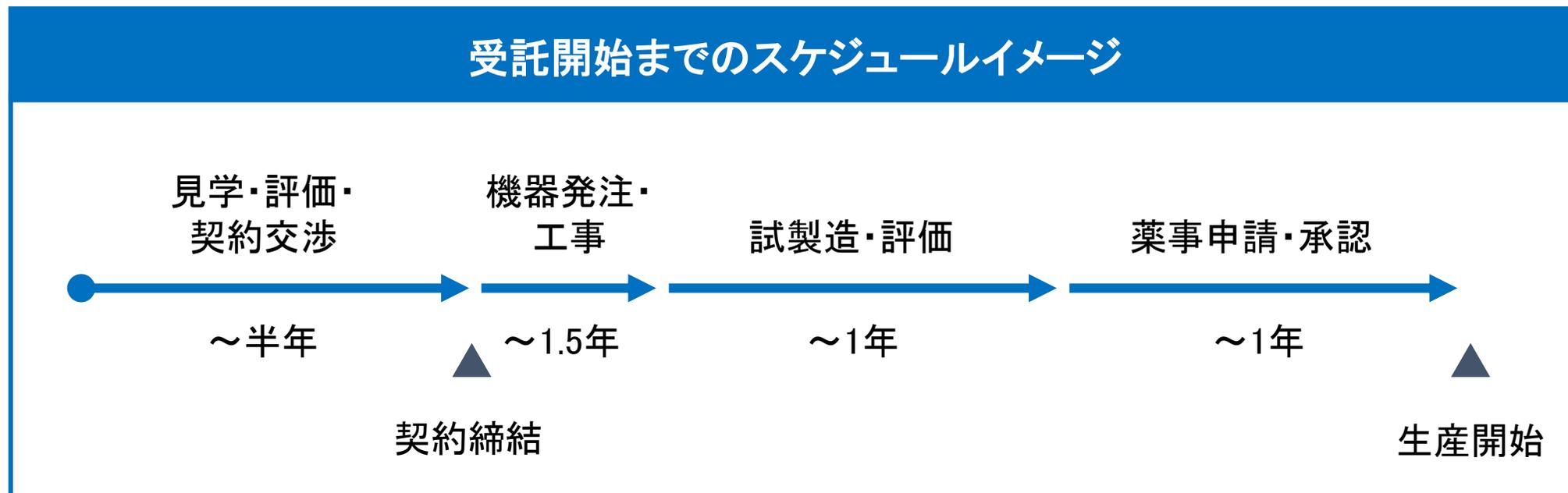
※ 医療上の必要性がある場合、
後発品が入手困難な場合を除く

選定療養の対象製品の 今期想定売上金額に占める割合



太陽ファルマテックの新規受託タイムライン

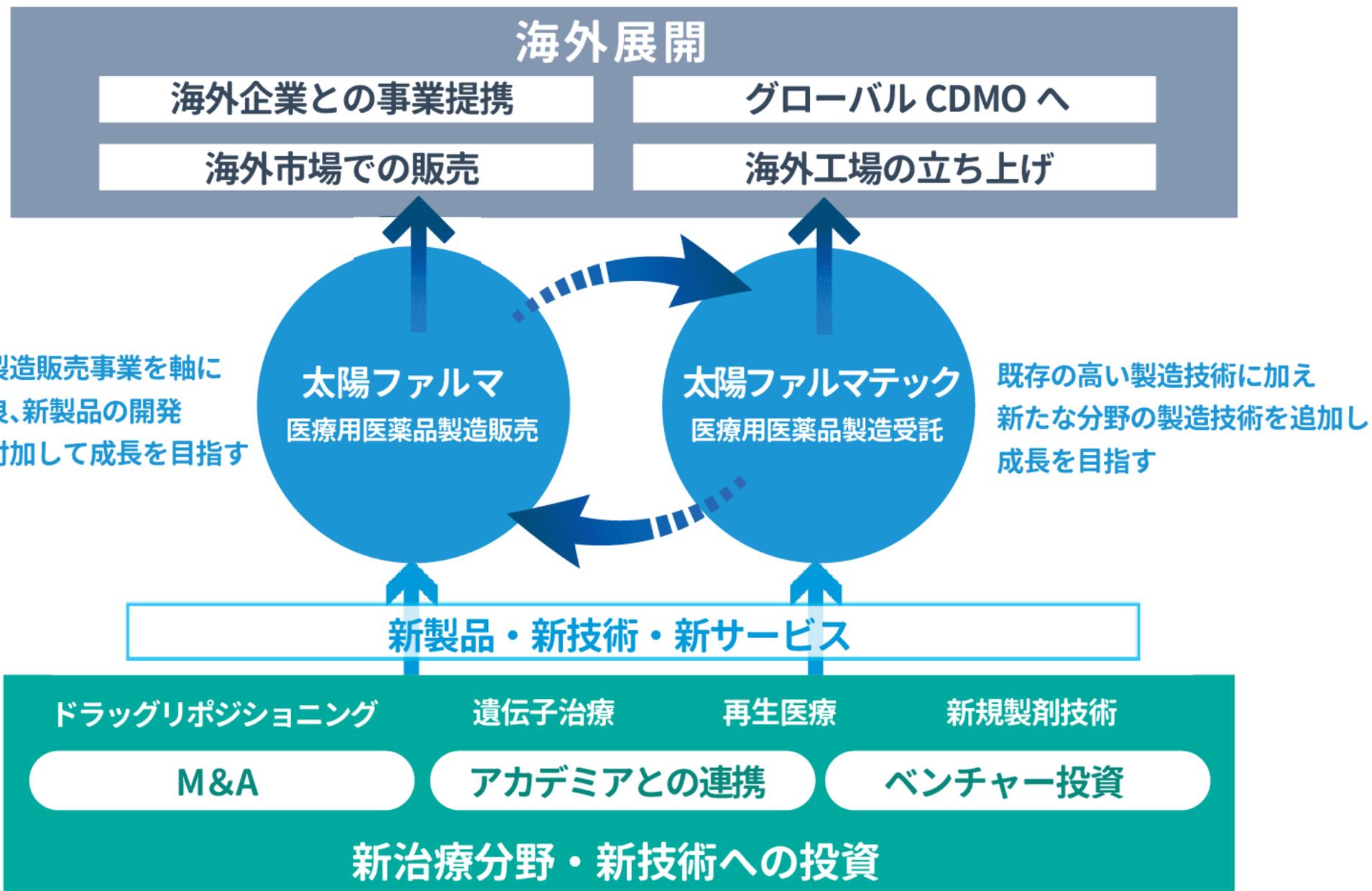
- ✓ 太陽ファルマテックの新規受託は、契約締結から生産開始まで3～4年の期間と受託開始まで時間を要します。



現在の主な契約締結済み案件

- 日系大手製薬会社 出荷開始済 22/3月期～
- GEヘルスケア 出荷開始済 23/3月期～
- 再生医療関連 受託開始済 23/3月期～
- 日系大手製薬会社 生産開始済 25/3月期～
- 外資系大手製薬会社 生産開始予定 25/3月期～

医療・医薬品事業 成長戦略

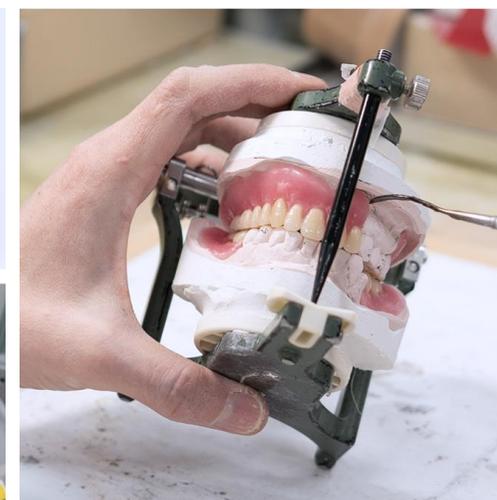


リックを連結子会社化

- ✓ 2022年3月より当社子会社であったリックを当第1四半期より連結子会社化しました。

Ricc 株式会社リックの概要

所在地	大阪市北区 大阪市東淀川区 東京都港区
設立	平成9年2月7日
代表者	代表取締役社長 有馬 聖夫 代表取締役副社長 井上 貴文
従業員数	131名(2024年6月末現在)
事業内容	歯科技工製品の製造、販売

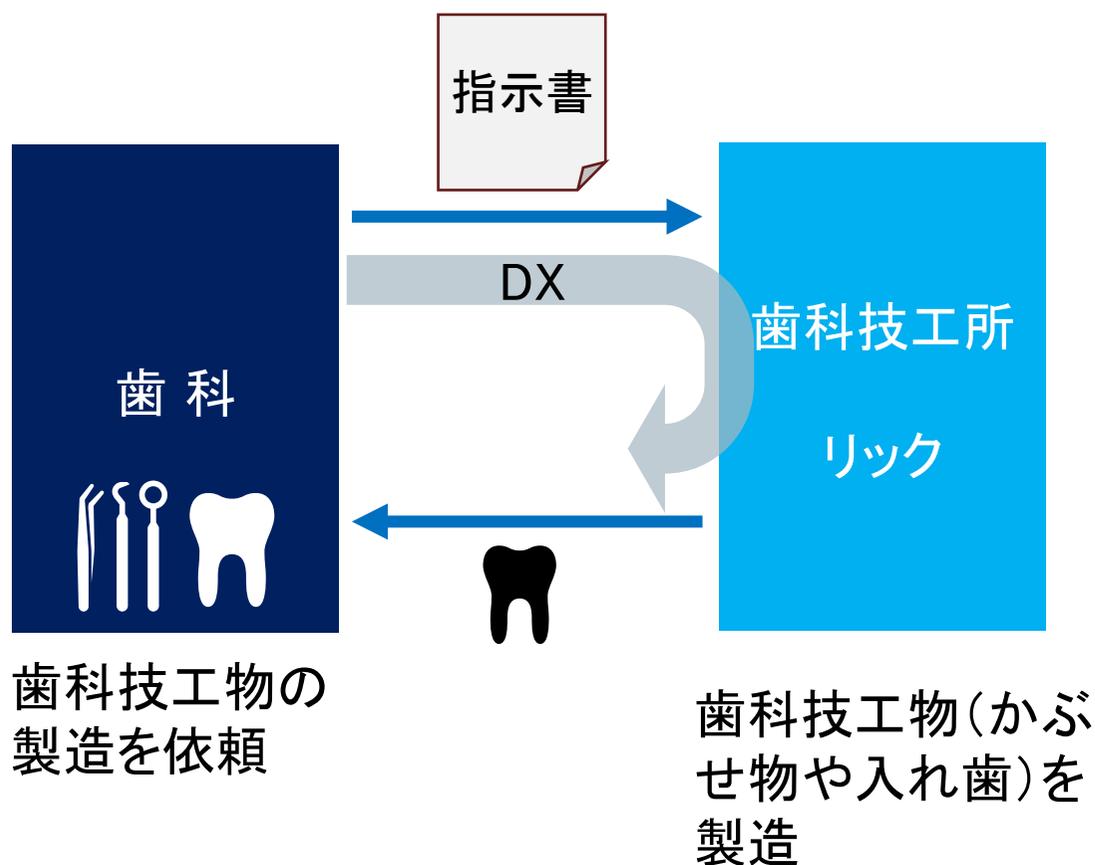


リックコーポレートサイト：<https://www.ricc-web.co.jp/>

リックの事業内容

- ✓ 2022年3月より当社子会社であったリックを当第1四半期より連結子会社化しました。

歯科技工所の役割



リックの取り組み

- 歯科技工物を提供
- CAD/CAM冠システム*の導入等、デジタル技術と匠の技の融合
- 3Dプリンターなどのデジタル技術活用による生産効率向上



*CAD/CAM冠システム: コンピュータによって歯科技工物の設計や・製造を支援するシステム



	ご質問	回答
エレキ	リジッド高機能のDF製品の開発状況は。	HDI(高密度配線基板)の分野においてもDFタイプSRの顧客評価が進んでおります。来期以降の採用を目指して、開発に取り組んでいる状況です。
	技術の流出リスクに対して、どのような対策を行っているか。	技術情報の保護に加えて、他社による当社製品の模倣品の作成を防ぐために、知的財産の権利化にも注力しています。販売先の地域も含め、各国にて知的財産の権利化を進めています。
医薬	26年3月期以降の医療・医薬品事業の業績推移はどのように考えているか。	長期経営構想にて医療・医薬品事業は26年3月期売上高300億円を掲げておりますが、TPTが行っているCDMO事業については、順調にすすんでおります。TYPの製造販売業については短期的にみると薬価改定や選定療養の影響等から売上げの減少が想定されますが、5～10年の長期的に見ると、薬価も下げ止まり、不採算品に関する取り組み等の効果が出て改善していけると考えております。
	CDMO事業は将来的にどのような規模感になっていくと考えているか。	長期経営構想で2030年に医療・医薬品事業の売上高600億円を掲げており、既存設備の限りでは、これに見合った規模感になると考えています。本資料27ページの説明にある通り、現在進めている案件の売上が立つのが4, 5年後になります。現状、2030年までについては予定から変更ないものとみています。また、設備のスペースに余裕はありますので、新規案件の獲得や、海外への進出等から、更なる成長の余地はありと考えております。
全社	長期経営構想で掲げているROE18%はどのように達成を目指すのか。	利益の向上、積極的な株主還元の実施により、ROE18%を目指してまいります。